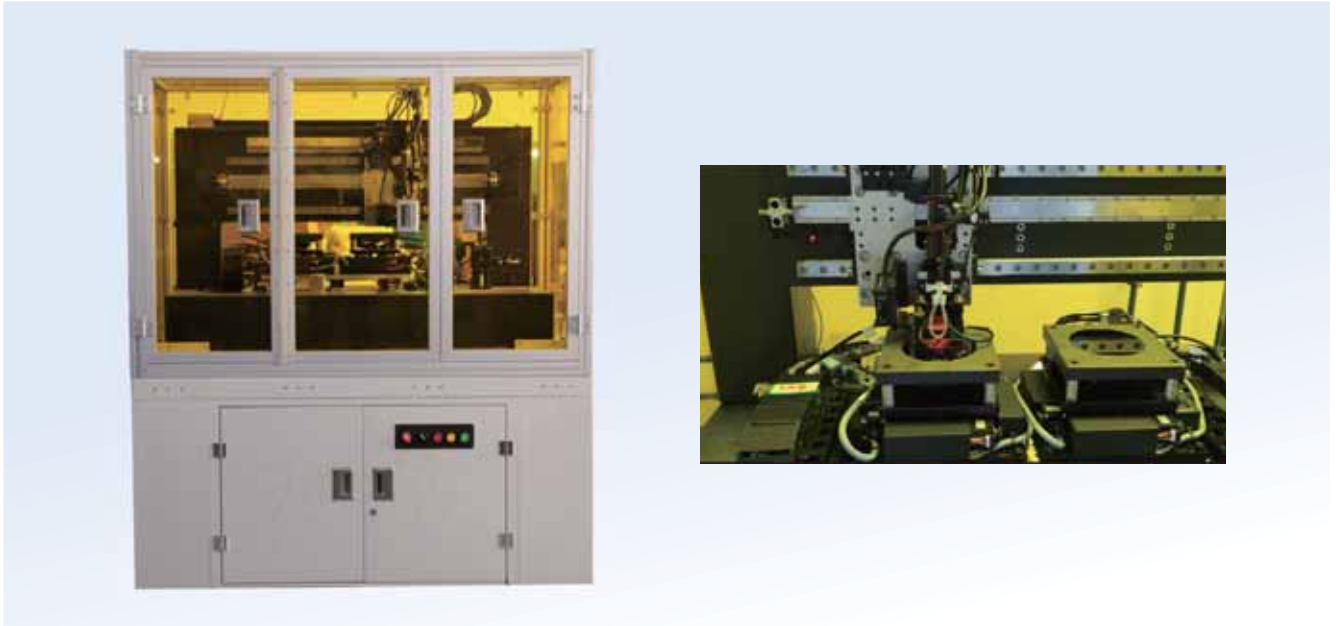


## 半导体晶圆微操作、检验设备



### 说明：

此系统是卓立汉光推出的针对半导体晶圆进行微操作、检验的通用开发平台。系统中包括：半导体晶圆装夹单元、半导体晶圆对位单元、机器视觉单元和微操作机械手单元，配套有完整的运动控制系统和机器视觉软件。可以根据客户不同的需求，实现对半导体晶圆进行装夹、对位、转印、清洁、检验等功能。

### 特点：

- 系统包含完整的装夹和对位结构，可以根据客户实际需求定制
- 控制系统和机器视觉系统留有二次开发接口
- 兼容客户不同的晶圆结构，不同的Mark点图形、进行不同的操作动作
- 可对半导体晶圆进行多维度微步调整
- 多工位配置，提高工作效率

### 系统参数：（本系列产品为设计规格，技术指标以最终发布内容为准）

指标	参数
机器视觉分辨率(μm)	0.1
显微镜倍率	0.5-4.5
摄像头分辨率	2048×1536
最高帧率 (fps)	15
摄像头类型	单色
光源	单色同轴光源
Mark点识别重复性(μm)	0.1
Mark点识别对位精度(μm)	<0.5
大行程X轴滑台行程 (mm)	400
大行程Y轴滑台行程 (mm)	200
大行程重复定位精度 (μm)	1
大行程运动分辨率 (μm)	±1
精密对位X轴滑台行程 (mm)	10
精密对位Y轴滑台行程 (mm)	10
精密对位Z轴滑台行程 (mm)	20
精密对位线性维度单向重复定位精度 (μm)	±1
精密对位线性运动分辨率 (μm)	0.1
精密对位θZ轴滑台行程 (°)	5
晶圆工位 (个)	2
晶圆真空吸附通道 (路)	4